

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

Disciplina: Compatibilidade Eletromagnética

Semestre: 2015/1

Carga horária total: 60h Carga horária teórica: 45h Carga horária prática: 15

Créditos: 4

Área temática: ENGELET Professor: Giovani Bulla

EMENTA

Introdução geral em compatibilidade eletromagnética. Princípios eletromagnéticos básicos. Conceito de compatibilidade eletromagnética entre equipamentos e o ambiente eletromagnético em que estão instalados. Emissão conduzida e irradiada. Susceptibilidade conduzida e irradiada. Técnicas de medição de EMC. Técnicas de modelagem numérica. Controle de interferência eletromagnética. Controle de descargas eletrostáticas. Trabalhos extraclasse e relatórios abordando atividades experimentais voltadas a situações reais de compatibilidade eletromagnética em produtos eletroeletrônicos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Introdução à Compatibilidade Eletromagnética;
- Campos Eletromagnéticos;
- Normas relativas à Compatibilidade Eletromagnética;
- Espectro de sinais no domínio de frequência e tempo;
- Princípios básicos de linhas de transmissão;
- Comportamento real de componentes eletrônicos;
- Emissão conduzida e suscetibilidade eletromagnética;
- Emissão irradiada e suscetibilidade eletromagnética;
- Princípios básicos de antenas para aplicações em compatibilidade eletromagnética;
- Fenômeno de crosstalk:
- Blindagens eletromagnéticas;
- Descargas eletrostáticas;



AVALIAÇÃO

- Elaboração de um artigo a ser apresentado nas formas oral e escrito; Obs: Os artigos deverão seguir um padrão editorial, como por ex.: Elsevier Editorial System.
- Avaliação escrita, englobando todo o conteúdo da disciplina.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CLAYTON, R. P. Introduction to Electromagnetic Compatibility. 2nd ed. New York: John Wiley Interscience, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BALANIS, C. A. Advanced Engineering Electromagnetics. New York: Wiley, 1989.

GOEDBLOED, J. J. Electromagnetic Compatibility. New Jersey: Prentice Hall, 1990.

KAISER, K. L. The Electromagnetic Compatibility Handbook. Boca Raton: CRC, 2005.

KENNEDY, G. Electronic Communications Systems. Madri: McGraw-Hill, 1970.

OTT, H. W. **Noise Reduction Techniques in Electronic Systems**. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1988.



Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

Disciplina: Fundamentos de Ciências dos Materiais

Semestre: 2015/1

Carga horária total: 60h Carga horária teórica: 60h Carga horária prática: 00

Créditos: 04 Área temática:

Professor: Tatiana Louise Avila de Campos Rocha

EMENTA

Introdução a Ciências dos Materiais, explorando o conhecimento e a correlação das estruturas atômica e cristalina com as propriedades dos diferentes tipos de materiais. Apresentação, classificação e aplicação das diferentes classes de materiais. Uso de ferramentas de seleção de materiais. Polímeros Condutores. Materiais para encapsulamento. Técnicas de caracterização química, física, elétrica e mecânica de materiais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Estrutura atômica / tabela periódica / Ligações químicas
- Estrutura e Planos cristalinos
- Imperfeições em sólidos/Difusão
- Microestruturas e Diagrama de Fases /
- Alterações microestrutrais/laboratório microestrutura de metais
- Relação Estrutura X Propriedades
- Propriedades Elétricas e Magnéticas
- Propriedades térmicas e óticas
- Ligas ferrosas e não ferrosas
- Introdução a materiais cerâmicos
- Introdução a materiais poliméricos
- Introdução à corrosão
- Introdução à Semicondutores
- Técnicas de caracterização de Materiais



AVALIAÇÃO

A ser definida pelo professor

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CALLISTER, W. D. **Fundamentals of Materials Science and Engineering:** An Integrated Approach. 4th ed. Amsterdam: Wiley, 2011.

LU, D.; WONG, C. P. Materials for Advanced Packaging. New York: Springer, 2009.

MOTHEO, A. J. Aspects on fundaments and applications of conducting polymers. Rijeka: InTech, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AKCELRUD, L. **Fundamentos da Ciência dos Polímeros.** São Paulo: Manole, 2006. CANEVAROLO, S. **Ciência de Polímeros.** 2. ed. São Paulo: Artliber, 2006.

PADILHA, A. F. **Materiais de Engenharia:** Microestrutura, propriedades. São José: Hemus, 2007.

SKOTHEIM, T. A. Handbook of conducting polymers. New York: M. Dekker, 1998.

VAN VLACK, L. **Princípios de ciência e tecnologia dos materiais.** 2. ed. São Paulo: Campus, 1984.



Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

Disciplina: SISTEMAS DISCRETOS

Semestre: 2015/1

Carga horária total: 60h Carga horária teórica:60 Carga horária prática:

Créditos: 4

Área temática: Automação e Controle Professor: Rodrigo Ivan Goytia Meija

EMENTA

Representação de sistemas dinâmicos em tempo discreto. Discretização de sistemas de tempo contínuo. Transformada Z e suas aplicações em análise e projeto de sistemas de controle em tempo discreto. Projeto de controladores digitais e suas aplicações em tempo real.

AVALIAÇÃO

Definido pelo professor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Astrom, Karl A.; Wittenmark, Bjorn. **Computer-Controlled Systems**: Theory and Design. 3rd ed. Dover Publications, USA, 2011. ISBN-10: 0486486133, ISBN-13: 978-0486486130.

FRANKLIN, G. F.; POWELL, J. D.; WORKMAN, M. **Digital Control of Dynamic Systems**. 3rd. ed. New Jersey: Addison Wesley, 2006.

OGATA, Katsuhiko. **Discrete-Time Control**. 2nd ed. New York: Prentice Hall. ISBN 10: 0130342815, ISBN-13: 978-0130342812

Bibliografia Complementar:

ASTRÖM, Karl J.; HÄGGLUND, Tore. **Advanced PID Control**. Duham: ISA - The Instrumentation, Systems, and Automation Society, 2005.

Kuo, B. C. Automatic Control Systems. New York: Prentice Hall, 2009.

LANDAU, Joan Doré; ZITO, Gianluca. **Digital Control Systems**: Design, Identification and Implementation. Amsterdam: Springer, 2006.

LEVINE, William S. The Control Handbook. New Jersey: CRC, 1996.



NORMAM, Nise. **Engenharia de Sistemas de Controle**. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005.

OGATA, Katsuhiko. **Engenharia De Controle Moderno**. 5 ed. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2008.



Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

Disciplina: Instrumentação para Controle e Automação

Semestre: 2015/1

Carga horária: 60 Carga horária teórica: 60 Carga horária prática: 00

Créditos: 04

Área temática: ENGELET

Código da disciplina: 108623

Requisitos de matrícula: Conhecimento de Eletrônica (amplificadores realimentados),

conhecimentos de Estatística.

Professor: Cesar David Paredes Crovato

EMENTA

Conceitos Gerais de Instrumentação e Controle. Transdutores e Sensores: Função de Transferência, Sensibilidade. Métodos e Sistemas de Medição. Erros, Determinação da Incerteza de Medição; Propagação Erros de Medição. Sensores de presença, posição, temperatura, radiação, pressão, nível, vazão, deformação, força, torque e características químicas. Métodos de compensação de não idealidades. Circuitos Eletrônicos Aplicados. Características Dinâmicas de um Sistema de Medição. Projeto de circuitos de condicionamento de Sinais.

AVALIAÇÃO

Apresentação de trabalhos de pesquisa em Seminário de Tópicos de Instrumentação. Projetos de Sistemas de Condicionamento e Aquisição e correção de não-idealidades. Atividades Individuais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Tópico 1 - Conceitos Gerais de Instrumentação e Controle. Transdutores e Sensores:

Função de Transferência, Sensibilidade.

Tópico 2 - Métodos e Sistemas de Medição: Métodos Diretos de Comparação; Padrões primários e secundários. Erros, Determinação da Incerteza de Medição; Propagação Erros de Medição.



Tópico 3 - Aspectos Gerais das Características Dinâmicas de um Sistema de Medição: Proposta de Modelo Matemático: Resposta dinâmica e sua análise: funções de transferência;

Tópico 4 - Classificação dos Sistemas de Medição quanto à resposta: ordem zero,

1. Ordem e 2. Ordem; Respostas a solicitações periódicas; Determinação Experimental dos Parâmetros Característicos de um Sistema ou Instrumento de Medição.

Tópico 5 - Dispositivos de Condicionamento de Sinais: circuitos em ponte e amplificadores especiais para instrumentação.

Tópico 6 - Sensores (diversos tipos)

Tópico 7 - Algoritmos de Medição.

Tópicos Especiais em Instrumentação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALVES, J. J. L. A. **Instrumentação, Controle e Automação de Processos**. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005.

BALBINOT, A.; BRUSAMARELLO, V. J. **Instrumentação e Fundamentos e Medidas**. Rio de Janeiro: LTC, v. 1 e 2, 2007.

DOEBELIN, E. O. **Measurement systems: application and design**. 5th ed. New York: McGraw Hill, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BECKWITH, J. G.; BUCK, N. L. **Mechanical measurements.** Hoboken: Reading/Addison-Wesley, 1961.

BEGA, E. A. Instrumentação Industrial. Rio de Janeiro: Interciência, 2006.

BORCHARDT, I. G.; ZARO, M. A. Extensômetros de Resistência Elétrica: Strain Gages. Porto Alegre: Editora da Universidade, 1982.

BORCHARDT, I. G.; BRITO, R. M. Fundamentos de instrumentação para monitoração e controle de processos. São Leopoldo: UNISINOS, 1998.

BORCHARDT, I. G.; GOMES, A. F. **Termometria Termoelétrica**. Porto Alegre: Sagra, 1982

CAMPILHO, A. Instrumentação Electrónica: Métodos e Técnicas de Medição. Porto: FEUP, 2000.

FIALHO, A. B. Instrumentação industrial: conceitos, aplicações e análises. 4. ed. São Paulo: Erica, 2006.



FRADEN, J. **Handbook of modern sensors: physics, designs, and applications**. New York: Springer-Verlag, 2004.

NORTON, H. **Handbook of transducers for eletronic measuring systems**. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1969.

OLIVER, F. Pratical instrumentation transducers. New York: Hayden Book, 1971.

SOISSON, H. E. Instrumentação Industrial. Curitiba: Hemus, 2002.

THEISEN, A. M. F. **Fundamentos da Metrologia Industrial**. Porto Alegre: SEBRAE, 1997.

TIMOSHENKO, S. P. Resistência dos materiais. Rio de Janeiro: LTC, v.1, 1985.

VUELO, J. H. Fundamentos da Teoria de Erros. São Paulo: Edgard Blücher, 2006.



Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

Disciplina: Modelagem de Sistemas

Semestre: 2015/1

Carga horária: 60 Carga horária teórica: 60 Carga horária campo: 00

Créditos: 04

Área temática: ENGELET

Código da disciplina: 108613

Requisitos de matrícula: -

Professor: Rodrigo Ivan Goytia Mejia

EMENTA

Estudo de processos físicos de diferentes áreas (fluídos, elétricos, térmicos, químicos) visando à análise de suas principais propriedades e características de funcionamento. Comportamento linear e não linear. Representação sistêmica. Modelagem e representação por diagramas em blocos. Noções de sistemas em malha aberta e malha fechada. Reconhecer e operar os principais componentes existentes em controle de processos. Modelagem paramétrica e não-paramétrica. Introdução as principais técnicas de identificação de sistemas: AR, ARX, ARMAX. Exercícios práticos. Modelagem de sistemas reais (voltados aos estudos de caso individuais).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

INTRODUÇÃO

- Estrutura da matéria;
- Introdução a modelagem de sistemas;

MÓDULO I – Modelagem, Análise, Controle e Simulação de Sistemas Automatizados

- PARTE I AUTÔMATOS E CONTROLE SUPERVISÓRIO
 - Introduão á disciplina;
 - <u>Linguagens formais e expressões regulares</u>: notações, definições, propriedades, operações básicas, representação de SEDs por linguagens, exemplos;



- <u>Autômatos</u>: definições, autômatos ADEF, operações básicas, determinização de autômatos ANDEF, equivalencia e minimização de autômatos, representação de SEDs por autômatos, exemplos;
- <u>Bloqueio e composição de autômatos</u>: bloqueio, acessibilidade, coacessibilidade, produto asíncrono e síncrono, lógica de controle, exemplos.
- Modelagem de SEDs: metodologia, abordagem global vs local, modelagem de plantas, modelagem de especificações, especificação não bloqueante, exemplos;
- Controle Supervisório de SEDs: esquema de controle, representação do supervisor, sistema em malha fechada, supervisor não bloqueante, exemplos.
 O problema de controle (PCS), controlabilidade e solução de PCS, síntese monolítica, abordagem modular local, exemplos;
- Metodologia para a síntese de supervisores ótimos: obtenção do modelo da planta; obtenção do modelo da especificação; síntese do supervisor ótimo não bloqueante; implementação/realização do supervisor;
- o <u>Implementação em controladores lógicos programáveis</u>.

• PARTE II - REDES DE PETRI

- <u>Definições e modelagem de Rede de Petri</u> (RdP): introdução, elementos básicos de modelagem, métodos de modelagem, modelagem de sistemas em RdP, exemplos;
- Propriedades e métodos de análise de RdP: propriedades dependentes da marcação inicial, propriedades estructurais, análise por enumeração de marcação, análise estructural, exemplos.
- Logica temporal linear (LTL): estruturas Kripke, arbore computacional, definições e nomenclatura LTL, expressando propriedades de transição de sistemas em LTL, equivalencias de formulas temporais, exemplos.
- <u>Redes de Petri especiais</u>: RdP interpretada, RdP temporizada e temporal,
 RdP Colorida;
- Verificação das propriedades lógicas (modelchecking);
- o Implementação em controladores lógicos programáveis (CLPs).

MÓDULO II – Modelagem, Análise e Simulação de Sistemas Dinâmicos.



- Introdução a modelagem de sistemas dinâmicos: Conceitos preliminares, construção de modelos matemáticos, classificação de modelos matemáticos, sistemas lineares e não-lineares, variantes e invariantes no tempo, de parâmetros agrupados e distribuídos, etc.;
- <u>Fundamentos de modelagem</u>: Modelagem verbal; Descrição de processos;
 Especificação de controle e conexões; Graus de liberdade; Diagramas de incidência;
 Modelagem do ruído;
- Equações de balanço da quantidade conservada: balanço de forças, balanço de massa, balanço de energia, balanço de entropia, balanço de entalpia, balanço de carga, balanço de calor, balanço de impulso, etc.;
- Modelagem de processos dinâmicos: Modelos dinâmicos empíricos e teóricos;
 Variáveis e equações de conservação; Balanço de massa volumétrica num tanque;
 Balanço de massa em dois tanques interconectados; Balanço de energia num tanque agitado e aquecido; Balanço de componentes num tanque agitado com uma reação;
 Sistemas elétricos, sistemas mecânicos rotacionais, sistemas mecânicos translacionais, sistemas eletromecânicos, sistemas fluídicos, sistemas térmicos, analogia entre modelos;
- <u>Linearização de equações não-lineares e variáveis de desvio</u>: Aproximação linear;
 Pontos de equilíbrio; Linearização para funções de uma variável, dois variáveis e múltiplas variáveis; Definição de variáveis de desvio; As variáveis de desvio e a simplificação da forma da equação;
- <u>Equações diferenciais ordinárias (ODEs) e o comportamento do sistema</u>: ODEs lineares; Resolvendo ODEs de 1ra ordem e 2da ordem; Caracterizando os processos de 1ra e 2da ordem;
- Representação de modelos: Representação por meio da transformada de Laplace;
 Funções de transferência típicas de processos; Representação por meio de espaço de estados; Realização de estados; Propriedades estruturais; Polos e zeros de processos mono e multivariáveis;
- <u>Diagrama de blocos</u>: Combinando funções de transferência usando diagrama de blocos; Diagrama de blocos de malha fechada; simplificação de diagrama de blocos; Aproximação de Padé;
- <u>Análise da estabilidade</u>: Análise da equação característica do sistema em malha fechada; Análise dos autovalores da matriz dinâmica A; Estabilidade de Lyapunoy;



• Aspectos numéricos da simulação de sistemas dinâmicos: tipos de modelos; tipos de problemas; tipos de métodos; métodos explícitos; erros; métodos de passo variável; métodos implícitos; estabilidade; sistemas rígidos "stiff"; sistemas de equações diferenciais algébricas acopladas (DAE); eventos e descontinuidades; pacotes e softwares para a resolução dos problemas de valor inicial para equações diferenciais ordinárias, de valor inicial para equações algébrico diferenciais e sistemas algébricos não-lineares;

AVALIAÇÃO

- Elaboração de trabalhos práticos em cada módulo do curso.
- Avaliação escrita, englobando todo o conteúdo de cada módulo.
- Elaboração e submissão em congresso ou revista de um artigo técnico ou científico.
 - Sendo um artigo técnico, este deve conter um texto de carácter expositivoargumentativo onde os autores apresentaram os resultados da aplicação prática de uma ou várias teorias, transmitindo conhecimentos do domínio da técnica.
 - Sendo um artigo científico, este deve também conter um texto de carácter expositivo-argumentativo em que os autores apresentaram e defenderão uma tese ou refuta de posições assumidas por outrem. Deste modo, funcionara como um difusor de conhecimentos científicos à comunidade, exprimindo o pensamento dos autores.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AGUIRRE, L. A. Introdução à Identificação de Sistemas, Técnicas Lineares e Não-Lineares Aplicadas a Sistemas Reais. Belo Horizonte, Brasil, UFMG, 3ª ed. 2007.

CARDOSO, J.; VALETTE, R. Redes de Petri. Florianópolis, 1997.

CASSANDRAS, C. G.; LAFORTUNE, S. Introduction to Discrete Event Systems. 2nd ed., USA, Springer, 2008.

COOPER, D. J. Practical Process Control using Control Station. 2004.

CURY, J. E. R. **Teoria de Controle Supervisório de Sistemas a Eventos Discretos** - Apostila - Notas de 2001, Mini-Curso V Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente.

GARCIA, C. Modelagem e Simulação de Processos Industriais e de Sistemas Eletromecânicos, São Paulo, USP, 2. ed. 2005.



LIMA II, E. J. Uma Metodologia para a Implementação Através de CLPs de Controle Supervisório de Células de Manufatura Utilizando Redes de Petri. 2002. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) — Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Federal da Bahia (UFBA).

MIKLES, J.; FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control, USA, Springer, 1st ed. 2007.

NUNES, G. C.; MEDEIROS, J. L. D.; ARAÚJO, O. D. Q. F. **Modelagem e Controle da Produção de Petróleo**, São Paulo, Blucher, 2010

OGUNNAIKE, B. A.; RAY, W. H. **Process Dynamics Modeling and Control**. Oxford University Press, 1994.



Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

Disciplina: Redes e Protocolos

Semestre: 2015/1

Carga horária: 60 Carga horária teórica: 60 Carga horária prática: 00

Créditos: 04

Área temática: ENGELET

Código da disciplina: 108628

Requisitos de matrícula: -

Professor: Marcio Rosa da Silva

EMENTA

Modelo de referência OSI/ISO. Camada física e de enlace em aplicações industriais: EIA 232C, EIA422, EIA 485, IEC 61158-2 e Ethernet. Camada enlace: Estratégia de arbitramento de acesso. Acesso determinístico e aleatório. Detecção e correção de rede. Prioridades. Camada de Rede: Estratégias de roteamento Camada de Transporte: Serviços orientados a conexão e não-orientados a conexão. Protocolos: MODBUS, PROFIBUS, FieldBus Foundation, CANbus. Protocolo TCP-IP. Protocolos DNP3 e suas aplicações na área elétrica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Modelagem de Redes.
- Modelo de referência OSI/ISO.
- Redes TCP/IP
- Redes Industriais
- Protocolo DNP3 e suas aplicações na área elétrica.

AVALIAÇÃO

Apresentação de trabalhos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FUROUSAN, B. Comunicação de dados e Redes de computadores. New York: McGrawHill, 2007.



MACKAY, S. **Practical Industrial Data Networks:** Design, Instalation and Troubleshooting. Amsterdam: Elsevier, 2003.

REYNDERS, D. **Practical Industrial Data Communications**. Amsterdam: Elsevier, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AGUIRRE, L. A. Enciclopédia de Automática. Oxford: Edgar Bluncher, v. 2, 2007.

KUROSE, J. **Redes de computadores e a internet:** uma nova abordagem. Pearson, 2004.

LOPEZ, R. A. **Sistemas de Redes para Controle e Automação**. Rio de Janeiro: Book Express, 2000.

TANENBAUM, A. Redes de computadores. São Paulo: Campus, 2003.



Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

Disciplina: Processos de Fabricação de Encapsulamentos

Semestre: 2014/1

Carga horária: 60 Carga horária teórica: 60 Carga horária prática: 00

Créditos: 04

Área temática: ENGELET Código da disciplina: 108619

Requisitos de matrícula: -

Professor: Willyan Hasenkamp Carreira

EMENTA

Diferentes tecnologias de encapsulamento e suas características. Etapas e equipamentos do processo de encapsulamento: polimento de wafers, serra de wafers, solda de chip (die attach), solda de fios (wire bonding), moldagem, corte e conformação, aplicação de esferas, separação, carimbo e inspeção. Módulos Multichip e encapsulamento COB, 3D, SiP. Flip Chip e TAB, Wafer Level Packaging - WLP. Leds, células solares e novas tecnologias de encapsulamento.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Encapsulamento de Semicondutores - Intro

Polimento & Serra

Solda de Chip & Solda de Fios

Moldagem, Marcação, Aplicação de esferas & Separação

Projeto de Encapsulamentos, CEP e Confiabilidade

CMP & PE – Chemical Mechanical Polishing & Plasma Etching

DBG & LD - Dice Before Grind & Laser Dicing

DAF & ACA - Die Attach Film & Anisotropic Conductive Adhesive

CuW & FC - Cu Wire & Flip Chip

STK & TSV – Stacking & Through Silicon Vias

MCP - Multi Chip Packaging (PoP, SiP, SOP)

PM - Packaging for Mobile (MCP, eMMC, eMCP, PoP)

WLCSP & COB - Wafer Level Chip Scale Packaging & Chip on Board



MP & CP - MEMS Packaging & Ceramic Packaging

TAB & FS - Tape Automated Bonding & Flexible Substrates

AVALIAÇÃO

Apresentação de trabalhos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BAKIR, M. S.; MEINDL, J. D. Integrated Interconnect Technologies for 3D Nanoelectronic Systems. 1st ed. Boston: Artech House, 2009.

HARPER, C. A. **Electronic Packaging and Interconnection Handbook**. 4th ed. New York: McGraw-Hill Professional, 2005.

TUMMALA, R. R. Fundamentals of Microsystems Packaging. 1st ed. New York: McGraw-Hill Professional, 2001.

TUMMALA, R. R.; RYMASZEWSKI, EUGENE J.; KLOPFENSTEIN, A. G. Microelectronics Packaging Handbook, Part I, II and III. 2nd ed. Massachusetts: 1997.

ARDEBILI, H.; PECHT, M. Encapsulation Technologies for Electronic Applications. Amsterdam: Elsevier, 2009.

GREIG, W. Integrated Circuit Packaging, Assembly and Interconnections. New York: Springer, 2010.

HARPER, C. Electronic Packaging and Interconnection Handbook. New York: McGraw-Hill, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GENG, H. **Semiconductor Manufacturing Handbook**. New York: McGraw-Hill, 2005.

Silicon Run Productions. Disponível em: < http://www.siliconrun.com/order.shtml>, Acessado em: 16 out. 2014.